

## TECHNISCHE DETAILS - FR4 – Standard

Parameter	Technische Angaben	Bemerkung
<b>Basismaterial</b>	FR4 TG130 - TG170, CEM 1, CEM 3, Rogers, Teflon, Polyimide	
<b>Lagenanzahl</b>	1 - 28 Lagen	
<b>Leiterplattendicke</b>	0,15 mm - 4,5 mm	Dickenbereich abhängig von der Lagenanzahl
<b>Kupfer</b>	17 - 385 µm	0,5 oz – 11 oz
<b>Leiterplattenabmessung</b>	600 x 1800 mm	
<b>Minimaler Bohrdurchmesser</b>	mechanisch: 0,2 mm gelasert: 0,075 mm	Durchmesser ab 6 mm werden gefräst.
<b>Aspect ratio</b>	1 : 12	
<b>Leiterbahnbreiten/Abstände</b>	75 µm / 75 µm	
<b>Lötstopplack</b>	Taiyo, Tamura, Probimer, Imagecure	photosensitive Lacke in verschiedenen Farben
<b>Oberflächen</b>	HAL-LF, Imm. NiAu, Imm. Tin, Imm. Silver, OSP, galvanisch NiAu	
<b>Drucktechnik</b>	Bestückungsdruck, Abziehlack, Karbonlack, Lochfüller	Bestückungsdruck in den Farben weiß, gelb, schwarz, rot, blau, grün
<b>Konturbearbeitung</b>	Ritzen, Fräsen, Stanzen, Anfasen, Senken, Bohren	Ritznut 30°, Fase mit 20°, 30° oder 45°
<b>Qualitätssicherung</b>	Fertigung nach IPC, AOI, E-Test, Mikroschliff, Erstmusterprüfung	Prüfspannung 150 bis 250 V, Prüfung nach Netzliste
<b>Weitere technische Möglichkeiten</b>	Sacklöcher und vergrabene Löcher, kontrollierte Impedanz	
<b>Technologische Besonderheiten</b>	Auf Anfrage	

Stand: Dezember 2015